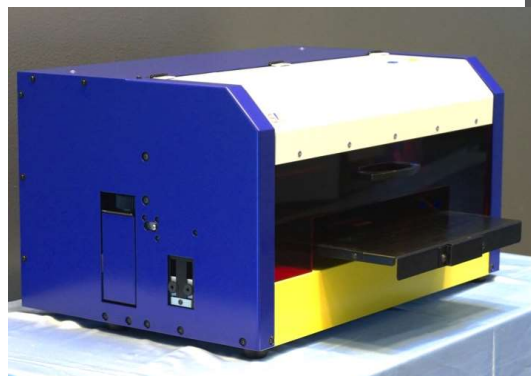


スマートプリンター

- ・レジストマスク形成、電気回路形成
 - ・A4サイズを約240秒で高速印刷
 - ・ユーザービリティの徹底追及
- 3つの動作で印刷スタート！
条件だしの手間を従来比80%削減！
インクの補充は1分で完了！**



特長

- ◆指定のインクジェット用インクを使用することで、ノズル詰まりを低減。
- ◆装置内にUV照射機を内蔵しているため、レジスト材の印刷及び硬化工程を同時に実現。
- ◆ユーザービリティを追求した独自機構によりインクの補充、交換が簡単。
- ◆プリントヘッドを交換することで、レジストマスク形成、導電回路形成の用途で使用可能。

用途例

レジストマスク形成用途

- ◆ガラス基板、光学部品への遮光用マスク印刷。
- ◆電気部品への絶縁パターン印刷。
- ◆銅張積層基板、銅張フィルムへのエッチングマスク印刷。
印刷後エッチングを行うことで回路基板を作成することができます。

電気回路形成用途

- ◆PETフィルム、PIフィルムへの銀ナノインク印刷。
印刷後に120度焼成させることで導電性の回路を作成することができます。

仕様

仕様	スマートプリンター SMP-3021
プリント方法	ピエゾ駆動型インクジェット方式 (最小線幅100 μ m ※条件により異なる場合があります。)
使用画像データ形式	ビットマップ(BMP)形式 (2値)
搭載可能メディア寸法	300mm(W)×210mm(D)×0.8mm以上30mm以下(H)
印刷速度	100mm/sec、250mm/sec (選択)
メディア固定方法	粘着テープによる貼り付け or 吸着ステージ
PCインターフェース	USB2.0 (WINDOWS7以上 32bit,64bitをご準備ください)
装置サイズ	約600mm(W)×350mm(D)×330mm(H)
本体電源及び消費電力	AC85～265V 消費電力100W以下



産総研技術移転ベンチャー

株式会社SIJテクノロジー

TEL

029-896-5110

FAX

029-896-5111

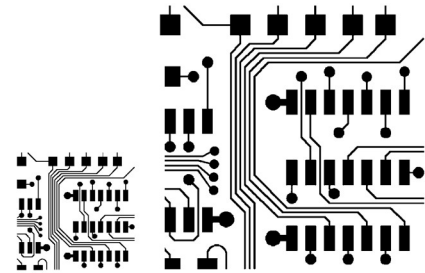
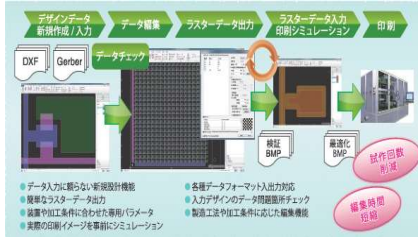
URL

www.sijtechnology.com/

印刷プロセス

Step1. 印刷データを作成(2値BMP形式)

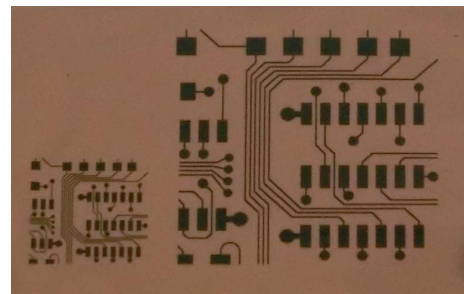
編集ソフト(DFM Inkjetなど)を用いて
DXF、Gerber、PDFデータをBMPデータに変換。



2値BMPデータ

Step2. スマートプリンターを用いて印刷

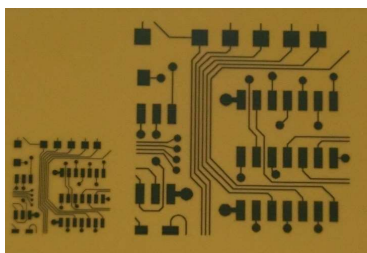
PCから装置を操作
基板をセットし、印刷ボタンを押すだけ。
※レジスト材印刷の場合は装置内でUV照射実施。



印刷後

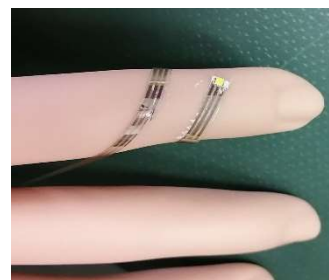
Step3. エッチング処理

レジストマスク形成
(エッチングマスク形成)

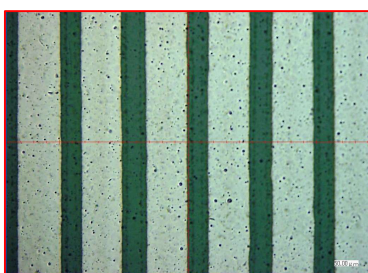


Step3. 焼成処理(120度 60分)

電気回路形成用途



Step4. レジスト材剥離処理



事例
基板: 銅張りPIフィルム
線幅: 200ミクロン
スペース: 50ミクロン

事例
基板: PETフィルム
線幅: 500ミクロン
スペース: 400ミクロン